
Thermal Annealing 효과에 의한 다층 박막 FBAR 소자의 공진 특성 개선

김동현, 임문혁, Mai Linh, 윤기완

한국정보통신대학원대학교

Improvement of Resonant Characteristics due to the Thermal Annealing Effect
in Multi-layer Thin-film SMR Devices

Dong-Hyun Kim, Munhyuk Yim, Mai Linh, and Giwan Yoon

Information and Communications University

E-mail : gwyoon@icu.ac.kr

이 논문은 디지털 미디어 연구소(Digital Media Lab)의 지원에 의하여 연구되었음

요 약

본 논문에서는 ZnO를 사용한 다층 박막 SMR 소자의 공진 특성을 개선하기 위해서 실리콘 기판 상부에 형성된 W/SiO₂의 Bragg reflector를 thermal annealing한다. SMR 소자의 공진 특성은 Bragg reflector에 적용된 annealing 조건에 의존함을 관찰할 수 있었다. annealing을 하지 않은 Bragg reflector를 갖는 SMR 소자와 비교했을 경우, 400°C/30min의 조건으로 annealing된 Bragg reflector를 갖는 SMR 소자가 가장 훌륭한 공진특성을 나타내었다. 새롭게 제안된 annealing 공정은 W/SiO₂ 다층 박막 Bragg reflector를 갖는 SMR 소자의 공진 특성을 효과적으로 개선시키는데 있어 매우 유용할 것으로 보인다.

ABSTRACT

In this work, we, for the first time, present the effects of the thermal annealing of the W/SiO₂ multi-layer quarter wavelength reflectors on the resonant properties of the ZnO-based SMR devices. In order to improve the resonant properties of the SMR devices, we annealed thermally the reflectors formed on a silicon substrate using a RF magnetron sputtering technique. As a result, the resonant properties of the SMR devices were observed to strongly depend on the annealing conditions applied to the reflectors. The SMR devices with the reflectors annealed at 400°C/30min showed excellent resonance properties as compared to those with the reflectors non-annealed (as-deposited). The newly proposed simple thermal annealing process will be very useful to more effectively improve the resonant properties of the future SMR devices with W/SiO₂ multi-layer quarter wavelength reflectors.

키워드

FBAR, Bragg reflector, Thermal annealing, ZnO, piezoelectric

I. 서 론

최근의, 무선 통신 기술의 급격한 발전은 RF와 마이크로웨이브 소자 분야에서 폭발적인 관심을

일으키고 있다. 특히, spectrum crowding이 증가함에 따라 high-performance filter 및 duplexer에 대한 요구는 계속 증가할 전망이다[1]. 현재까지는 세라믹 듀플렉서가 front end filtering에 대한 엄격

한 요구를 만족시킬 수 있는 유일한 실용 기술이었다. 그러나 세라믹 뒤플렉서는 physical size 면에 있어 문제가 있고, SAW device는 상업적인 뒤플렉서에 사용될 수 있을 만큼 충분한 Figure of Merit 이 없다[2]. Film Bulk Acoustic Resonator (FBAR) 소자는 작은 크기와 고성능, MMIC 구현에 있어서의 강한 잠재력으로 인해 가장 주목받는 소자의 하나로 인식되고 있을 뿐 아니라, miniaturized filter, CDMA PCS용 duplexer 용융을 위해 전 세계적으로 폭넓게 연구되고 있다[3-4]. 박막으로 구성되는 FBAR 소자는 제작 방식에 따라 Membrane type, Air gap type, quarter wavelength reflector를 갖는 SMR type으로 분류된다. 이 중에서 Solidly Mounted Resonator (SMR) type FBAR는 acoustic 임피던스가 다른 물질을 격충으로 증착하여 반사 손실을 최소화하는 reflector를 가지므로 기판과 압전층 간을 acoustically isolation 시킬 수 있다[5]. SMR이 좋은 공진 특성을 갖기 위해서는 Bragg reflector가 잘 구성되어야 한다. 다층구조의 Bragg reflector를 이용하는 SMR의 제작방식은 대부분 RF sputtering 방법을 사용하여 공진 주파수의 $\lambda/4$ 두께를 갖도록 acoustic 임피던스가 다른 물질들을 증착한다.

본 연구에서는 RF magnetron sputtering 방식으로 증착된 Bragg reflector층을 annealing 처리하여 Bragg reflector의 quality를 향상시켜 보다 나은 공진 특성을 갖는 FBAR의 제작 공정을 확립하였다. 박막이 Thermal annealing 처리를 하는 공정은 잘 확립되어 알려져 있지만 아직까지 Bragg reflector의 형성에 적용하여 FBAR의 제작에 사용된 경우는 보고된 바 없다. 본 연구에서는 같은 증착 조건으로 형성된 Bragg reflector를 각각 다른 온도에서 annealing하여 FBAR 소자를 제작한 후 S-parameter를 추출하고 annealing되지 않은 소자와의 비교를 통해 공진 특성의 변화를 고찰하였다. 가장 좋은 공진 특성을 보이는 것은 400°C/30min의 조건에서 annealing된 FBAR 소자였다. 따라서 열 어닐링 공정이 다층구조의 Bragg reflector를 갖는 SMR의 제작에 매우 효과적인 공정 단계가 될 수 있을 것으로 생각된다.

II. 실험

본 연구에서는 한 장의 3인치 실리콘 웨이퍼 상에서 동일한 조건을 이용하여 다수의 FBAR를 제작하고 테스트하였다. 일반적으로 많이 연구되고 있는 SMR 형태의 FBAR는 그림 1의 (d)에서 알 수 있듯이, 실리콘 기판 상에 다층구조의 Bragg reflector가 있고, 그 위에 ZnO(혹은 AlN) 압전 박막이 2개의 전극사이에 샌드위치 형태로 끼어있는 구조로 제작된다. 먼저, RF Magnetron Sputtering systems을 이용하여 3인치 실리콘 웨이퍼 상에 SiO₂/W를 0.6um/0.55um 두께로 격충 증착하여 acoustic Bragg reflector를 제작한다. 각각의 층은

acoustic wave가 실리콘 기판 쪽으로 투과되는 것을 방지하기 위해 공진 주파수의 $\lambda/4$ 두께를 갖는다. Bragg Reflector 형성이 끝난 웨이퍼는 4등분되어 Thermal annealing 공정에 사용된다. Thermal annealing은 Gas를 주입하지 않은 상태에서 3가지 온도 조건에서 수행되었다. Thermal annealing 온도 조건은 200°C/30min, 400°C/30min, 600°C/30min이다. Thermal annealing 공정 처리된 샘플들은 소자의 제작이 끝난 후 Thermal annealing 되지 않은 하나의 샘플과 비교된다. Thermal annealing 공정이 끝난 후에, Al 하부 전극을 0.13um 두께로 증착한다. ZnO 박막은 상온에서 실리콘 기판 상에서 1.5um 두께로 증착된다. 상부 전극 패턴을 위한 포토리소그래피 공정을 수행한 뒤, 다시 Al을 0.13um 두께로 증착하여 lift-off 공정을 수행하면 상부 전극의 패턴이 완성되어 최종적으로 소자의 제작공정이 마무리된다. 제작된 one-port FBAR 소자의 상부전극 패턴들과 schematic diagram이 그림 1에 보여진다.

III. 결과 및 논의

제작된 FBAR은 Thermal annealing 하지 않은 것(A-type), 200°C/30min에서 한 것(B-type), 400°C/30min에서 한 것(C-type), 600°C/30min에서 한 것(D-type)과 같이 모두 4가지로 구분된다. 4가지 type 각각의 FBAR에 대해서 reflection coefficient(S_{11})를 측정하였다. 14개의 서로 다른 상부 전극 패턴을 이용하여 FBAR 소자의 라이브러리를 구성하고 그 중에서 가장 특성이 좋게 나온 3개의 상부 전극 패턴을 기반으로 하여 Bragg reflector의 Thermal annealing 효과로 인한 FBAR의 reflection coefficient에 대한 경향성을 고찰하였다. 그림 1에서 알 수 있는 바와 같이, S-parameter 측정을 위해서 RF signal이 하나의 signal contact과 두 개의 ground contact를 갖는 상부전극에 인가되었다. 그림 2에 세 가지 전극 패턴을 가지는 FBAR에 대한 return loss 측정결과를 나타내었다. 그림에서 (a)는 pattern 1의 상부전극을 갖는 FBAR의 반사계수 특성이고 (b)는 pattern 2의, (c)는 pattern 3의 반사계수 특성을 나타낸다. 전극 패턴의 structure 및 공진 면적의 차이로 인해 각 소자의 반사계수 특성은 약간씩의 차이를 보이지만 개별 소자에서 annealing 온도에 따른 반사계수 특성이 상대적으로 향상됨은 충분히 확인 할 수 있다. 세 가지 그림에서 보듯이 400°C/30min의 조건에서 Thermal annealing된 one-port FBAR 소자가 상대적으로 보다 향상된 반사계수 특성을 가짐을 알 수 있다. SMR 탑입의 FBAR에서는 반사 손실을 막기 위한 최적의 두께를 갖는 Bragg reflector를 제작하는 것이 중요한 점인데, Bragg reflector는 RF magnetron sputtering에 의해 제작된 실리콘 옥사이드 및 텅스텐 박막에 의한 다층 구조이므로 막의 품질이 좋지 않을 것으로 생각된다. 그러나 그림에서

보여 지듯이 어닐링 효과를 도입하면 FBAR의 반사계수 특성의 향상에 좋은 영향을 줄 수 있음을 알 수 있다.

그림3에 입력 임피던스 위상의 기울기가 주파수의 함수로서 나타나 있다. 각 전극 패턴 별로 annealing된 온도에 따라 공진 주파수가 달라지는 것을 알 수 있다. 이와 같은 공진 주파수의 변화는 결과적으로 FBAR의 Q-factor에 영향을 준다. 그림 3을 이용하여 계산된 직렬 및 병렬 공진에 대한 Q-factor 값을 표1에 나타내었다. annealing된 FBAR가 annealing 처리되지 않은 것에 비해 상대적으로 Q-factor가 크게 향상된 것을 알 수 있다. 특히, 400°C/30min의 조건에서 annealing된 FBAR의 경우에는 다른 것들에 비해 상대적으로 큰 Q-factor를 가짐을 알 수 있다.

IV. Conclusion

같은 증착 조건으로 형성된 Bragg reflector를 갖는 FBAR 소자를 서로 다른 온도에서 annealing하여 S-parameter를 추출하고 annealing되지 않은 소자와의 비교를 통해 공진 특성의 변화를 고찰하였다. 400°C/30min의 조건에서 annealing된 FBAR 소자가 가장 좋은 공진 특성을 보였다. Thermal annealing 공정이 다중구조의 Bragg reflector를 갖는 SMR의 제작에는 매우 효과적인 단계가 될 수 있을 거라고 생각된다.

참고 문헌

- [1] K. M. Lakin, G. R. Kline, and K. T. McCarron, "Development of miniature filters for wireless applications", IEEE Trans. Microwave Theory & Tech., Vol 43, pp 2933-2939, 1995.
- [2] R. C. Ruby, P. Bradley, Y. Oshmyansky, and A. Chien, "Thin film bulk wave acoustic resonators (FBAR) for wireless applications", IEEE Ultrasonics Symp., pp 813-821, 2001.
- [3] S. H. Park, B. C. Seo, H. D. Park, and G. Yoon, "Film bulk acoustic resonator fabrication for radio frequency filter applications", Jpn. J. Appl. Phys., Vol 39, pp 4115-4119, 2000.
- [4] R. Ruby, P. Bradley, J. D. Larson III, and Y. Oshmyansky, "PCS 1900MHz duplexer using thin film bulk acoustic resonators", IEE Electron. Lett., Vol 35, pp 794-795, 1999.
- [5] K. M. Lakin, K. T. McCarron, and R. E. Rose, "Solidly mounted resonators and filters", IEEE Ultrasonics Symp., pp 905-908, 1995.

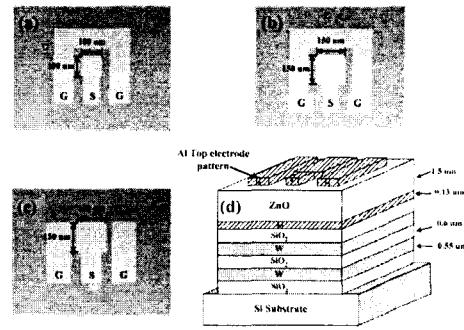


그림 1. 3 가지의 상부전극 패턴 및 제작된 FBAR 소자의 3차원 도식적 그림 : (a) pattern 1, (b) pattern 2, (c) pattern 3, and (d) 각각의 상부 전극 패턴이 적용되는 FBAR 소자의 3차원 도식적 그림

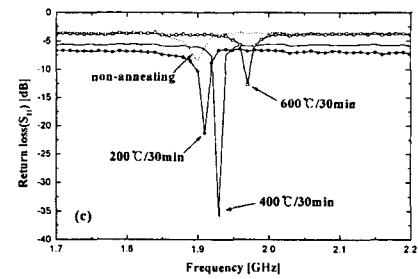
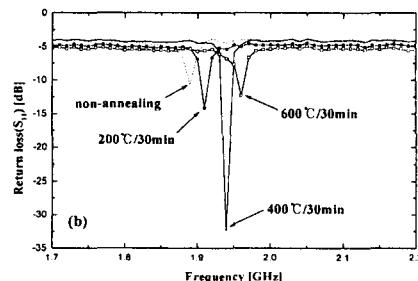
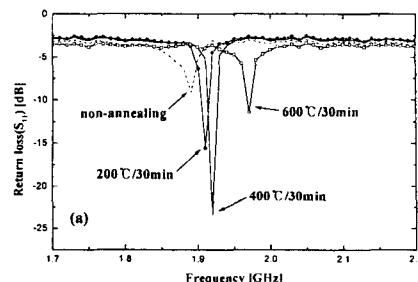


그림 2. 주파수의 함수로 나타난 다양한 어닐링 조건에 따른 Return loss 특성: (a) pattern 1, (b) pattern 2, (c) pattern 3

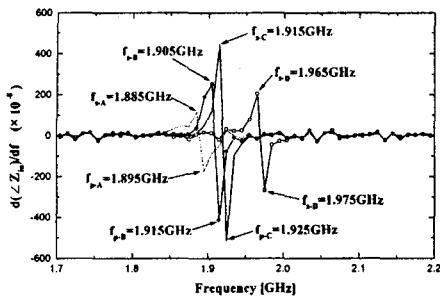


그림 3. 상부전극 pattern 1을 갖는 FBAR에 대한 주파수의 함수로 나타난 입력 임피던스 위상($\angle Z_u$)의 기울기: 직렬 및 병렬 공진주파수는 각각 f_s , f_p 로 표시되었고 첨자 A, B, C, and D는 각각 non-annealing, 200°C/30min annealing, 400°C/30min annealing, 그리고 600°C/30min의 annealing 조건을 가리킨다.

표 1. 다양한 annealing 조건에 따른 3 가지 공진기 pattern에 대한 직렬 Q-factors (Q_s) 및 병렬 Q-factors (Q_p)

	Pattern 1		Pattern 2		Pattern 3	
	Q_s	Q_p	Q_s	Q_p	Q_s	Q_p
Non-annealing	1082	1660	1100	2145	934	1418
200°C / 30min	2406	3951	1775	3119	1833	2297
400°C / 30min	4264	4961	2850	4966	2300	4264
600°C / 30min	2000	2639	1470	2175	2326	2983